

ラメラ晶<lamellae crystal>

高分子単結晶自身及び結晶性高分子の中に出来る高分子鎖が折りたたまれた板状結晶のこと。このラメラ晶がリボン状の結晶となって放射線状に成長したのが球晶であり、この球晶が成形品中に存在し、成形品の性質に影響を及ぼす。

ランナー<runner>

射出成形またはトランスファ成形用多数個取り金型での成形材料の分配流路をいう。また、この流路内で固化した材料をさすこともある。ノズルから射出された材料は、スプル、ランナーを通りゲートを経てキャビティに充填される

リフローハンダ<reflow soldering>

電気・電子部品をプリント基板上に実装するときのハンダ付け方法の一つ。ハンダペーストを基板上に塗布し、この上にチップを固定し高温雰囲気内でハンダ付けする方法。従来のデッソップ方式と比べて、実装密度の高いものに対応できる。

リブ<rib>

製品の肉厚を厚くしないで剛性や強度をもたせ、また広い平面部のソリを防ぐために用いる補強構造部分。

リム（RIM）成形法<reaction injection molding>

＝反応射出成形。低分子量かつ低粘度の液状モノマーを圧力下にミキシングヘッド中で混合すると同時に密閉金型内に射出し、金型内で重合反応を完結させて成形品を得る成形法、熱可塑性樹脂ではナイロンの成形がよく行われている。

ロックウェル硬度<Rockwell hardness>

押し込み硬さの一種で、鋼球を試験片面に抑圧し、試験片にできた凹みの深さから、硬さの数値を求めたもの。荷重と鋼球径との組合せによって、いろいろのスケールがある。プラスチックでは R、L および M のスケールがよく用いられる。